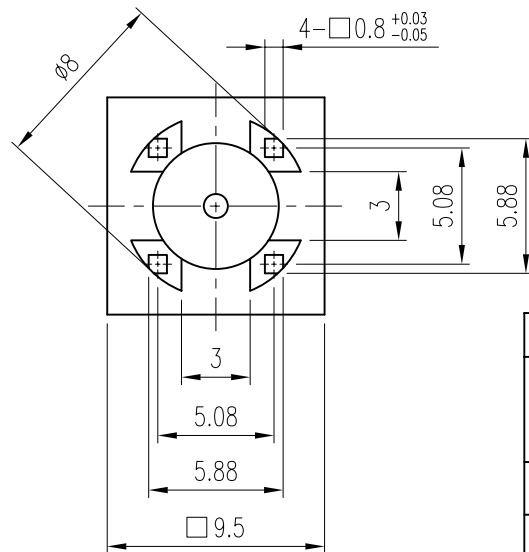
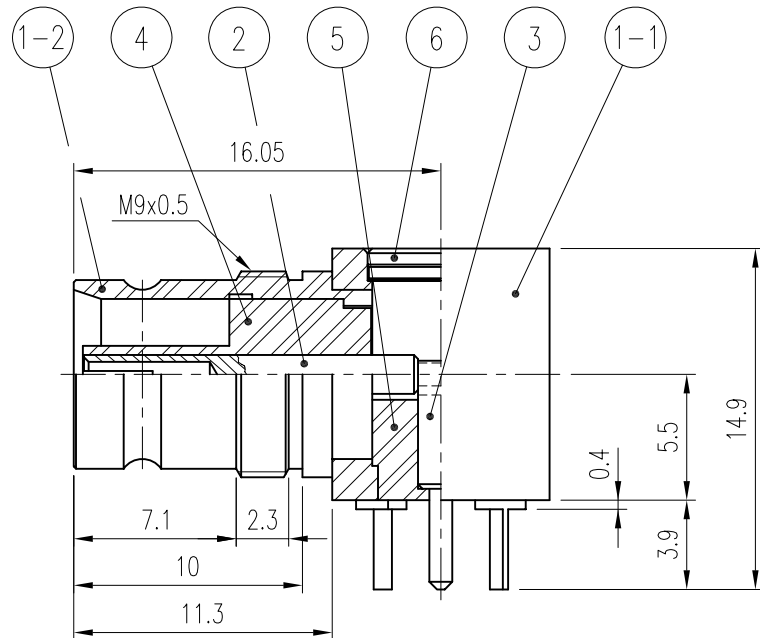


ST	가공											수 정 내 용				
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											△					
ST(개선)											△					



6	COVER	1	TEFLON		DCO00047-15/1 (L5007)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00835-N/1 (H5015)
4	INSULATOR	1	TEFLON	Gold Plate	DIN00838-N/1 (H5014)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00891-135/1 (E5023)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00895-1345/1 (E5012)
1	1-2 BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB001116-3/1 (D5016B)
	1-1 BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB001177-5/1 (D5016A)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		1997. 5. 31.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인								
재질	검도					도명 1.6/5.6DIN-LJ-4R-R			
	재도								
열처리	작성부서		연 구 소			A4			
보호피막처리	적도	NS	단위	mm	중량				
						K318-666-000			